

## 达索系统向北美扩展3DEXPERIENCE Lab最新开放式创新实验室与初创企业加速器

2017年2月7日，达索系统在SOLIDWORKS World 2017上宣布向北美扩展3DEXPERIENCE Lab开放式创新实验室与初创企业加速器，这代表了3DEXPERIENCE Lab在不断加强的全球影响力方面迈出了崭新的一步，将促进潜力无限的企业家项目推动社会变革。

北美3DEXPERIENCE Lab将于2017年5月在波士顿附近的达索系统美国总部建立，来自北美各地不同行业创新部门或研究实验领域的初创公司、企业家、学生、制造商和个人，如具备涉及城市、生活服务、生活方式、物联网、微观装配实验室或创意主题的项目意向，都能使用达索系统的云端3DEXPERIENCE平台，并获得其指导培训以及全球生态系统的支持，这是未来一至两年加速其产品开发计划的一部分。

同时，3DEXPERIENCE Lab还将提供全新的数字微观装配空间，该空间与麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）的比特和原子研究中心共同设计建立的。在微观装配实验室（Fab Lab）中，创新人士能使用先进的计算机控制工具和工艺来创建产品原型，或优化其产品理念。此外，该微观装配实验室还将作为未来的软硬件接口实验室，将设计和微观装配工具整合至端到端的实时系统中。

3DEXPERIENCE Lab于2015年11月率先在欧洲启动，旨在打造开放式创新的新框架，倡导企业家精神，为社会推进未来创意。该计划能帮助创新人士优化和验证产品及流程，其所采用的相同的虚拟协作化应用和专业技术已经对于当前产品的设计、制造和支持方式产生了变革。

该计划在多个不同行业已经带来了成功的项目，推进一系列的措施来促进产品、自然和生活的和谐发展。其中包括使用机器人开展大规模增材建造，3D打印个性化器官用于手术模拟，具备直升机和常规飞机功能的开源无人机以及沉浸式虚拟现实环境绘图的上游创新技术。”

## Gartner:三星、苹果2016年继续领跑全球最大半导体客户

2017年2月17日，信息技术研究和顾问公司Gartner表示，2016年三星电子（Samsung Electronics）与苹果（Apple）仍为半导体芯片最大买家，占全球市场整体需求的18.2%。2016年三星与苹果共计消费了价值617亿美元的半导体，较2015年增加了4亿美元。

2016年，虽然三星电子在智能手机、LCD电视与LCD面板等市场都遭遇来自中国大陆OEM厂商的激烈竞争，但该公司的设计总体有效市场（TAM）仍见增长，并以9.3%的市场占有率再度成为全球拥有最大设计总体有效市场的企业。而自2007年Gartner涉及总体有效市场的相关研究以来，苹果则是首见摔跌，其全年市场份额滑落至8.8%，主要原因在于2016年iPad销售状况不佳，以及苹果在个人电脑（PC）方面也流失部分市场份额。

2015年排名前十的企业中，有九家在2016年仍名列前十。思科（Cisco Systems）跌落前十名榜外，取而代之的则是在2016年快速增长的中国大陆智能手机厂商步步高通信设备（BBK Electronics）。

## IBM支持TensorFlow 为PowerAI人工智能开发者拓展更多选择

日前，IBM宣布，其PowerAI人工智能开发平台现在支持由谷歌原创的TensorFlow 0.12架构。PowerAI人工智能平台基于POWER 8体系结构，用于开源机器学习和深度学习架构。通过IBM的PowerAI人工智能平台，TensorFlow能为企业开发先进的机器学习产品与系统，提供新的快速、灵活以及产能完备的开发工具。

IBM所研发的PowerAI人工智能平台，支持企业级开源机器学习和深度学习架构，以构建相应的认知应用。PowerAI人工智能平台能够减少企业在Power体系结构上部署这类开源架构时的复杂性和风险。Power系统使用的是搭载NVIDIA NVLink技术的IBM POWER 8处理器，该处理器能够通过高速的NVLink接口连接到NVIDIA的Tesla Pascal P100 GPU加速器上。GPU到CPU以及CPU到GPU之间的NVLink连接，大幅度提升了深度学习和分析应用的性能。